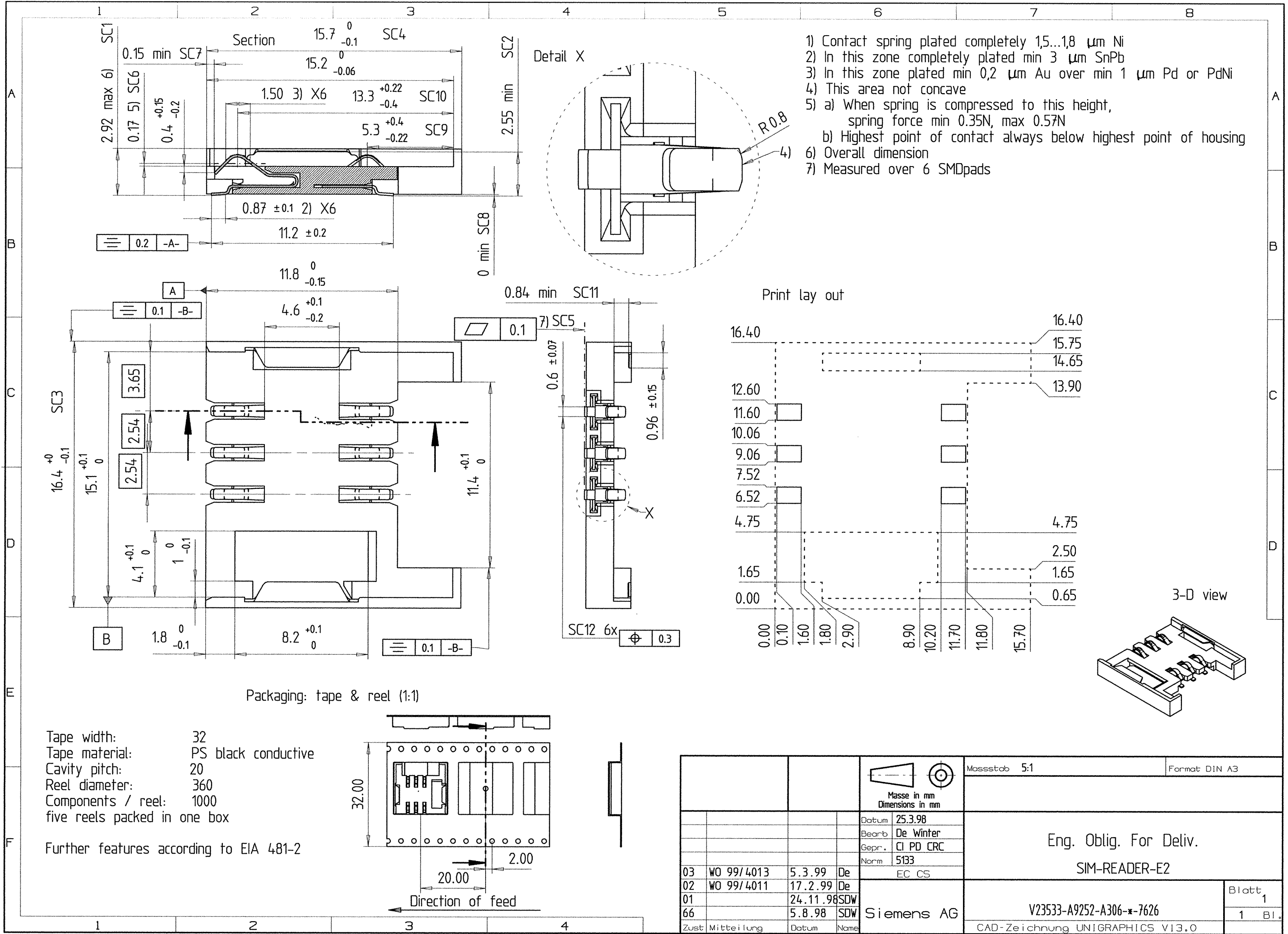


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung des Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung der Siemens AG. Die Reproduktion, Transmission oder die Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Siemens AG. Der Inhalt ist nicht geschützt, soweit nicht ausdrücklich angegeben. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Patenterteilung oder des Marken-Eintrags.



- 1) Contact spring plated completely 1,5...1,8 μm Ni
- 2) In this zone completely plated min 3 μm SnPb
- 3) In this zone plated min 0,2 μm Au over min 1 μm Pd or PdNi
- 4) This area not concave
- 5) a) When spring is compressed to this height, spring force min 0.35N, max 0.57N
b) Highest point of contact always below highest point of housing
- 6) Overall dimension
- 7) Measured over 6 SMDpads

Tape width: 32
 Tape material: PS black conductive
 Cavity pitch: 20
 Reel diameter: 360
 Components / reel: 1000
 five reels packed in one box

Further features according to EIA 481-2

				Masstab 5:1	Format DIN A3
		Datum 25.3.98 Bearb. De Winter Gepr. CI PD CRC Norm 5133 EC CS		Eng. Oblig. For Deliv. SIM-READER-E2	
03	WO 99/4013	5.3.99	De		
02	WO 99/4011	17.2.99	De		
01		24.11.98	SDW		
66		5.8.98	SDW		
Zust Mitteilung		Datum	Name	Siemens AG V23533-A9252-A306-*-7626 CAD-Zeichnung UNIGRAPHICS V13.0	
				Blatt 1 1 Bl.	